

[release_AXP-200]

【Thermalright 社ロープロファイル仕様 CPU クーラー-AXP-200 発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は台湾 Thermalright 社製品「AXP-200」を 2013 年 11 月 6 日(水)より発売開始いたします。

AXP-200 は、AXP-100 同様にロープロファイルタイプと言う点を開発コンセプトとし、トップフロー方式を採用した CPU ファンです。AXP-100 との比較において、ヒートシンク面積は約 1.7 倍大きくなり、これに従い冷却ファンを 100mm ラウンドファンから 140mm ラウンドファンへと強化、冷却能力を向上させております。そしてすでに販売しているオプションファン「TY-150」をサポート。さらに冷却能力を強化することが可能です。

ヒートパイプは、AXP-100 同様に銅製 6mm 径を 6 本搭載。ヒートパイプにコーティングを施すことで、冷却能力を損なうことなく長期間運用時においても酸化しにくくなっております。

対応 CPU は、他の Thermalright 社製品同様に、ユニバーサルブラケットシステムを採用し、幅広い CPU に対応しております。

AXP-200 は、ロープロファイル CPU クーラーでありながらも、高い冷却能力をもつ CPU クーラーです。

製品名 : AXP-200(JAN : 4571388250623)

店頭想定価格 : ¥8,000 円前後(税込み)

製品特徴:

- ヒートシンク+ファンで全高約 73mm のロープロファイル仕様 CPU クーラー
- 専用スリム型ラウンドファン TY-14013 を搭載
- 現在主に流通している CPU に対応可能なユニバーサルプラットフォーム仕様

[release_AXP-200]

製品仕様:

材質	銅・アルミ	
ヒートパイプ	6mm 6本	
ヒートシンク部寸法	150mm-60mm-140mm	
付属ファン寸法	150mm-140mm-13mm	
ファン回転数	700~1300rpm	
ファンノイズレベル	~30.68dB(A)	
ファン風量	~64.52CFM	
重量	ヒートシンク 475g/ファン 90g	
対応 CPU	intel	2011/1366/115x/775
	AMD	FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

製品画像



[release_AXP-200]

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/axp-200/>

画像データ(20.5MB) <http://www.dirac.jp/download/axp-200-img.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。